

各 位

会 社 名 エ ン シ ュ ウ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長
社長執行役員 松山 智彦
(コード：6218 スタンダード)
問合せ先 工作機械事業本部
新市場グループ 久米 憲一
(TEL. 053-588-0211)

微細・高精度加工に対応する小型マシニングセンタ

「SVHP ハイプレシジョン」を開発

— 微細加工を、もっと身近に。微細加工の新しいスタンダード。JIMTOF 2026 で初公開 —

エンシュウ株式会社（以下「当社」）は、立形マシニングセンタ「SV」シリーズの新機種として、微細・高精度加工に対応する「SVHP（ハイプレシジョン）」を開発しました。

本製品は、半導体・電子部品分野をはじめ、幅広い分野の小型精密部品の加工に対応します。微細・高精度加工に求められる機能を標準装備し、多様な加工ニーズに応えます。

本製品は、2026 年 10 月 26 日（月）から 10 月 31 日（土）まで東京ビッグサイトで開催される「JIMTOF 2026」の当社ブースに出展し、同時に受注を開始します。本製品の投入を通じて、当社工作機械事業における高付加価値領域の拡充と、新たな顧客基盤の開拓を進めてまいります。

記

1. 開発の背景と当社の狙い

半導体や電子部品の精密化・高機能化に伴い、微細・高精度加工へのニーズが高まっています。当社はこうした需要に応えるため、長年培ってきた工作機械の設計・製造技術を生かし、微細・高精度加工に求められる性能を追求したマシニングセンタ「SVHP」を開発しました。

本製品は、幅広い分野の小型精密部品加工に対応し、多様化・高度化する微細加工ニーズに応えます。

2. 主な特長

① 高剛性・低重心設計による振動対策

機械の剛性向上と低重心設計により、加工時の振動を抑制し、当社従来機に対し精度が大幅向上。コラムの剛性は、従来機比 3 割以上向上。さらに、重心位置を低くし、機械動作時の安定性を向上。

② 高分解能光学式スケールによる高精度位置決め

高分解能光学式スケールを標準装備し、従来機より分解能を向上し、正確で繰返し性の高い位置決めにより、安定した高精度加工を支えます。

③ 機械・切削液・主軸の温度管理

6 万回転で主軸変位量が従来機比 6 割低減。温度管理で長時間にわたる高精度加工を実現。

機械本体の温度モニタリングに加え、切削液の温度調整機能、主軸冷却とモータ冷却を標準装備し、温度変化による加工精度への影響を抑えます。

④ 最適な切削条件を実現する 6 万回転主軸

最高 60,000min⁻¹の高速回転に対応し、加工材料や工具に応じた柔軟な条件設定が可能。微細・高精度加工の領域で高い加工性能を発揮します。

⑤ 省スペース

従来の Saving Center のコンセプトを引き継ぎ、機械の高さ 2m 以下を実現。

3. 装置概要

テーブルサイズ (mm)	400 × 250
ストローク (mm)	X:320 Y:400 Z:250
早送り速度 (m/min)	30
主軸テーパ	HSKE-25
機械の高さ (mm)	1,980
所要床面積 (mm)	1,910 × 2,130
機械重量 (kg)	1,900

4. 製品外観

